

证券代码：300656

证券简称：民德电子

## 深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-04

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称	中欧基金、前海开源基金、红杉资本、富国基金、嘉实基金、诺安基金、银河基金、兴业基金、光大保德信基金、泰信基金、新华基金、交银施罗德基金、创金合信基金、长安基金、长城基金、恒生前海基金、深圳纽富斯投资、深圳火神投资、Kontiki Capital、Fountain Bridge、工银国际、平安银行、华安财保、信泰人寿、中银三星人寿、北大方正人寿、华泰资产、国投安信、蔷薇资本、西藏源乘投资、瑞腾基金、上海易同基金、上海顶天投资、上海磐厚投资、上海博鸿投资、上海明河投资、上海尘星资管、上海天猷投资、上海五地基金、敦和资管、劲棒资本、深圳红方资产、深圳明曜投资、深圳泽源基金、广东正圆基金、广州睿融基金、广东恒昇基金、百川财富、北京厚特投资、北京城天九投资、北京星石投资、浙江华舟资产、杭州军璐投资、杭州凯岩投资、宁银理财、宁波三登投资、中信证券、中信建投证券、天风证券、安信证券、财通证券、西部证券、东吴证券、招商证券、中国银河证券、方正证券、华安证券、开源证券、长城证券、华福证券、中邮证券、首创证券
时间	2023年4月25日、2023年4月27日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：高健 证券事务代表：陈国兵
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、公司情况介绍</b> <b>1、近期重要事项进展</b> (1) 晶圆代工厂广芯微电子，预计于2023年5月19日正式投产通线，将彻底打开公司功率半导体业务产能扩张的天花板，且后续产品开发效率方面会更加高效、可控。

晶圆代工厂是整个 smartIDM 生态圈中最重要的环节，广芯微电子项目的建成投产，将是公司功率半导体 smart IDM 生态圈构建过程中具有里程碑意义的关键一步，为公司在功率半导体产业长期发展构建深厚的护城河，这也将是公司区别于其他国内功率半导体纯设计公司的最大核心竞争优势。

(2) 超薄背道代工厂芯微泰克，近期已完成主体厂房封顶，预计将于今年三季度投产，芯微泰克将与广芯微电子一起，为国内优秀的创新型功率半导体设计公司提供高性能晶圆代工和超薄背道代工整体解决方案。

(3) 功率半导体设计公司广微集成，在 12 英寸晶圆代工厂生产的 SGT-MOSFET 产品在新产品开发、量产和销售方面均进展顺利，60V 系列产品已量产，80V、100V 系列产品将于上半年实现量产。SGT-MOSFET 产品以晶圆片和芯片成品两种方式对外销售；经过一季度的客户验证，目前晶圆片销量逐月快速增长，并计划今年 5 月启动 SGT-MOSFET 芯片成品销售，产品主要面向 BMS 电源管理市场。预计 SGT-MOSFET 今年将为广微集成贡献显著的收入增长。

(4) 晶圆原材料公司晶睿电子，自 2021 年 8 月投产以来保持高速扩产，2022 年实现销售额近 3 亿元，净利润近 4,000 万元。目前二期项目（面向智能感知系统应用的特种硅片）和碳化硅外延片项目均进入试生产阶段，近期将给客户送样测试。

小结：经过近三年时间在功率半导体产业链的布局，公司已完成 smart IDM 生态圈构建，且产业链各环节企业今年将全部进入量产阶段，未来会保持持续扩产，公司未来五年将步入快速增长阶段。

## 2、公司 2022 年度及 2023 年一季度业绩变化情况说明

### (1) 2022 年度业绩变化情况说明

2022 年，公司实现总营业收入 51,819.73 万元，较上年同期减少 2,809 万元，主要是广微集成因 6 英寸代工产能切换导致产销量下降，广微集成 2022 年度的收入较 2021 年减少约 2,000 万元。伴随广微集成在 12 英寸晶圆代工厂 SGT-MOSFET 量产销售及广芯微电子投产，广微集成产能瓶颈将得到彻底解决，产销量将保持持续增长。

2022 年实现归属上市公司股东的净利润 8,971 万元，较上年同期增加 1,358 万元。增加利润的项目包括：转让晶睿电子 2% 的股权收益，以及晶睿电子业绩增长为公司贡献的净利润，同时理财和利息收益也增加了部分收益；减少利润的项目包括：广微集成产销量下降导致净利润减少；泰博迅睿去年受电芯涨价等影响，电池业务毛利率下降，

利润减少；同时公司对泰博迅睿收购时形成的商誉也减值了约 550 万。

公司 2022 年的经营活动产生的现金流净额较上年同期增加 3,096 万元，同比增加约 65%。

#### (2) 2023 年一季度业绩变化情况说明

2023 年一季度，公司实现营业收入 7,345 万元，同比减少 1,472 万元。主要是泰博迅睿的营收减少约 1,300 万元，因泰博迅睿在持续优化客户，缩减了部分回款周期长、毛利率较低的业务，后续将更多资金转向更优质的业务，所以一季度收入有所下降；另外，广微集成 MOS 场效应二极管产品（6 英寸）一季度主要依靠库存销售，收入减少约 600 万元；一季度公司条码业务销售额增加了近 400 万元。

2023 年一季度实现归属上市公司股东的净利润 594 万元，同比减少约 787 万。减少的主要原因：一是联营企业投资收益部分降低，包括广芯微、芯微泰克等联营企业尚处于建设期，人员费用支出较去年同期有增加；二是公司借款金额增大，财务费用有所增加；三是广微集成与泰博迅睿的收入减少，对应利润也有所减少。此外，条码业务一季度利润有所增加。

2023 年一季度的经营活动产生的现金流净额较上年同期增加约 900 万元，同比增加约 67%。

### 3、主要业务板块经营近况及未来展望

#### (1) 功率半导体业务

1) 设计公司广微集成，其 6 英寸晶圆代工产能切换，后续将主要集中在广芯微电子，待今年广芯微电子投产通线后将彻底打开产能扩张天花板；另外，广微集成在 12 英寸晶圆代工厂生产的 SGT-MOSFET，目前锁定产能为 2,000 片/月，目前在快速上量，今年也将有显著业绩贡献。

2) 晶圆代工厂广芯微电子，预计将于 5 月 19 日投产通线，产能会得到逐步释放，产能提升具体进度视设备调试情况及市场情况。一期月产能预计最终可达到在 12-14 万片，主要以 6 英寸代工产能为主，配有少量 8 英寸代工产能；以硅基产品为主，以碳化硅产品为辅。此外，我们已预留了二期项目用地，建设 8 英寸或 12 英寸晶圆代工产线，后续将视市场情况启动建设。

3) 超薄背道代工企业芯微泰克，近期主体厂房已封顶，预计今年三季度投产，一期投资 3 亿多元。待一期项目满产后，会继续启动二期项目建设。

4) 晶圆原材料企业晶睿电子, 投产以来一直保持持续扩产, 硅外延片产销量大幅提升。二期项目(面向智能感知系统应用的特种硅片)和碳化硅外延片近期投产, 今年也将贡献增长。2022年底晶睿电子完成新一轮数亿元融资, 估值较民德电子投入时已提升5倍多, 后续晶睿电子会保持持续扩产。

#### (2) 条码识别设备业务

2022年受消费市场低迷影响, 条码识别设备业务应收略有下滑, 2023年一季度有所改善, 营收同比增长百分之十几, 且一季度公司新增十余家品牌制造业客户。未来五年, 条码业务争取实现年均20%左右的业绩增长。

## 二、问答环节

### 问题 1: 公司在功率半导体业务各环节投资的企业, 未来股权会如何安排?

答: 公司目前在功率半导体领域投资的联营企业包括晶睿电子、广芯微电子和芯微泰克。(1) 晶睿电子: 公司目前持有晶睿电子 22.0963%的股权, 晶睿电子已确定独立进行 IPO, 预计今年启动股改。(2) 广芯微电子: 晶圆代工环节是整个 smart IDM 生态圈中最核心的环节, 是对公司构建长期护城河有重要影响力的核心资产, 公司目前对广芯微电子有足够的影响力, 未来不排除并入上市公司的可能性, 但目前无具体规划——首先, 广芯微电子项目一期总投资十几亿, 其中设备投入和基建投入约各占一半, 设备部分主要由上市公司全资子公司民德(丽水)出资购买, 产权归属于上市公司; 其次, 广芯微电子股权结构方面, 谢刚博士持有 36.06%, 民德电子持有 34.43%, 丽水市两家政府基金各持有 14.75%, 根据两家丽水市政府基金增资时的协议约定, 民德电子有权在其投资期内以本金加上一定的投资收益率享有主动回购其部分股权的权力, 如履行完相应回购权力, 民德电子持股比例最高可达 50%; 最后, 广芯微电子暂不考虑接受外部机构的投资。后续公司将与谢刚博士在综合考虑上市公司股东利益最大化、广芯微电子经营团队激励机制有效性、资本市场情况等因素后, 对广芯微电子做进一步资本规划。(3) 芯微泰克: 公司持有芯微泰克 33.33%的股权, 其尚处于建设阶段, 丽水市政府基金近期将对芯微泰克进行投资, 芯微泰克一期项目建设资金充足, 暂未放开对外部投资机构的融资。

### 问题 2: 公司在碳化硅产品方面的进度如何?

答: 公司在功率半导体硅基器件和碳化硅器件领域均是基于供应链自主可控的战略

进行布局。目前，公司在碳化硅领域已投资布局包括外延生产、晶圆代工、超薄背道代工、芯片设计等关键环节，完成了供应链核心环节布局。其中，晶睿电子的碳化硅外延已开始送样，客户包括国内外知名功率半导体厂商，若验证合格后将批量出货；广芯微电子和芯微泰克的晶圆加工产线均在加紧建设中，今年均计划开展碳化硅器件相关代工业务。后续公司将基于自主可控供应链，并结合市场情况，推出满足客户需求的碳化硅功率器件。

**问题 3：一季度特斯拉表示要降低碳化硅产品的用量，这一趋势对公司而言的影响如何？**

答：埃隆·马斯克在今年 3 月初特斯拉投资者交流会上对碳化硅产品的看法是，碳化硅器件虽性能很好，但价格太高，难以大规模应用，特斯拉仍采用碳化硅器件和硅基器件组合的方案。碳化硅功率器件在高电压、高开关频率、高功率密度等应用领域有非常大的优势，未来如果碳化硅器件的主要供应链都能实现国产化，成本大幅下降，其市场空间非常大。

目前，广芯微电子的碳化硅晶圆加工线已在进行安装调试等工作，其前道工序大部分可以和硅基产品共用。广芯微电子会以硅基产品为主，碳化硅产品为辅，相较于其它只做碳化硅产品的厂商，从固定资产折旧摊销角度，广芯微电子是按照硅基和碳化硅产品一起进行摊销，成本方面会具有明显的优势。

今年我们会保持对碳化硅领域的重点关注，我们近期也了解到国内碳化硅产业链在国产化和降本方面有很多积极的进展，尤其国内碳化硅衬底厂商扩产进度大幅提升。我们会积极关注碳化硅产业链的发展情况，在适当时机加大碳化硅产业链各环节的投入和产能。

**问题 4：广芯微电子今年量产产品有哪些，每款产品的产量大概有多少？**

答：广芯微电子预计 5 月 19 日投产通线，今年计划量产的产品包括 MOS 场效应二极管、900-1500V 高压 MOS、IGBT、碳化硅功率器件等产品。广芯微电子一期产能规划 12-14 万片/月，每款产品产量后续将根据产线调试进度、市场状况等进行动态调节。

**问题 5：广微集成产品的毛利率情况如何？**

答：广微集成目前在销产品主要有 MOS 场效应二极管和 SGT-MOSFET。MOS 场效应二极管主要以销售晶圆片裸片的半成品为主，近几年毛利率在 20-30%，后续待产能切换至广芯微电子晶圆代工厂，其代工成本有望得到改善；同时，广微集成目前也在进行成品

	<p>测试验证，后续将逐步启动成品销售，产品毛利率有望得到进一步提升。SGT-MOSFET 目前在 12 英寸晶圆代工厂生产，因初期产能较小，代工费用较高，后续随着规模增加，单片成本将会降低，产品毛利率会有明显提升。</p> <p><b>问题 6：2023 年一季报中提到，公司对联营企业投资收益下降。去年一季度联营企业包括哪些？今年同比下滑的主要原因？</b></p> <p>答：公司 2022 年一季度对公司合并报表利润影响较大的联营企业只有晶睿电子，2023 年一季度则包括了晶睿电子、广芯微电子和芯微泰克。广芯微电子和芯微泰克目前尚处于工程建设阶段，今年将陆续投产，因此人员较去年同期相比增加较多，员工费用支出有较大提升，导致公司投资收益下降。后续随着晶睿电子不断扩产，广芯微电子和芯微泰克的投产，对联营企业投资收益将得到不断改善。</p> <p><b>问题 7：公司如何看待商誉减值方面的压力？</b></p> <p>答：公司目前剩余的商誉金额约 1.1 亿元，包括泰博迅睿的 4,008 万元、广微集成的 6,612 万元和君安技术的 375 万元。泰博迅睿近几年商誉已累计计提减值 0.67 亿元，目前仅剩余 4 千万元；广微集成根据目前经营情况和后续发展情况，暂未出现减值迹象。随着公司规模的不增大，商誉金额占比将逐步减小，商誉减值风险在可控范围内。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023-04-27